



2019年6月6日

各位

会社名：株式会社システム ディ
代表者：代表取締役会長 堂山 道生
(コード番号：3804)
問合せ先：取締役経営企画室長 藤田 雅己
電話：075-256-7777 (代)

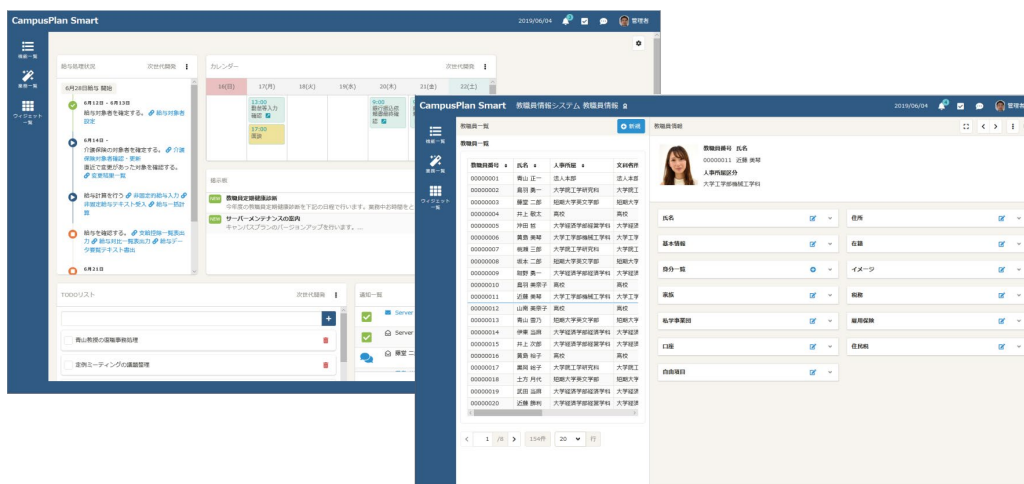
システムディ、新製品『次世代学園総合情報システム CampusPlan Smart』発表

第10回教育ITソリューションEXPO／第3回[関西]教育ITソリューションEXPOに出展

特定業種、特定業務向けにパッケージシステムを開発・販売する株式会社システムディ(所在地：京都市中京区、代表者：堂山 道生、以下：システムディ)は、大学・高校・専門学校等に対し学園向けトータルソリューション『キャンパスプラン』シリーズを提供しており、1985年の発売以来、全国の学校法人、大学、短大、専門学校、高等学校、中学校を対象に約1,000校でご活用いただいております。

この度、新たに『キャンパスプラン』シリーズを大幅にリニューアルして、新製品『次世代学園総合情報システム CampusPlan Smart』の開発を進めておりましたが、いよいよこの6月に開催される「第10回教育ITソリューションEXPO」にて発表いたします。

新製品『CampusPlan Smart』は、AI、IoT、RPA など人とモノが繋がっていく超スマート社会(Society5.0)に対応して、基盤設計からシステムを見直し、利用者が「操作に迷わない」「予定を忘れない」「処理を間違わない」という三つの操作性を実現し、便利に使えるだけでなく、今までにないパフォーマンスを実現するため、以下のようなコンセプトで開発しております。



CampusPlan Smart

■業務全体が見通せる・見渡せる

従来の個別の作業をこなすだけでなく、業務フローに沿って全体の進捗をチェックしながら、業務を遂行できるように業務メニューを実装します。

■作業の動線を把握できる

『カスタマージャーニーマップ』を作成し、お客様の要求機能を満たすだけのシステムから、お客様が行いたいことに気持ちよく応えるシステムになっています。

■マニュアルレスで操作を覚えなくても使える

従来なら 2 ステップも 3 ステップも操作が必要であった複雑な処理を、できるだけシンプルな操作でスムーズに実行できるようにし、マニュアルを見なくても正確かつスピーディに処理します。

■システムとユーザーのコラボレーション力を高める

必要なタイミングでシステムからお知らせが届いたり、ダッシュボード画面に配置された『ウィジェット』により様々な情報把握や各機能へのリンクができ、他部署の職員との間で情報共有するメッセージを送受信できる等、使用する方の業務の隅々まで寄り添う機能を充実させています。

将来的には、画像認識スキャナや RPA と連携した伝票の自動起票や、毎月・毎年発生する作業の自動化も想定しています。

正式リリースは 2019 年秋を予定しておりますが、システムの開発コンセプトやロードマップのご説明と、開発中β版を、以下展示会の当社ブースで展示いたします。

- ・6月19日(水)～21日(金)に東京ビッグサイト青海展示棟で開催の「第10回教育 IT ソリューション EXPO」
- ・9月25日(水)～27日(金)にインテックス大阪で開催の「第3回[関西]教育 IT ソリューション EXPO」

実際に製品のデモンストレーションをご覧いただけて、ゆっくり席に座ってお話できるスペースもご用意しております。

「第10回教育 IT ソリューション EXPO」出展のご案内

<https://www.systemd.co.jp/archives/14744>

【会社概要】

名称 : 株式会社システムディ(JASDAQ : 証券コード 3804)

所在地 : 京都市中京区烏丸通り三条上る

設立 : 1982年4月28日

資本金 : 4億8,426万円

従業員数 : 224名

代表者 : 代表取締役 堂山 道生

TEL : 075-256-7777(代)

URL : <http://www.systemd.co.jp/>

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社システムディ

担当者： 学園ソリューション事業部 藤原

TEL : 075-256-7585

FAX : 075-256-7590

E-mail : fujiwara@systemd.co.jp